

台灣發明商品促進協會 函

機關地址：台北市松山區八德路二段400號
7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：國立臺南護理專科學校

發文日期：中華民國114年12月30日

發文字號：台發協字第1140123001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(ATTCH1 文稿1_0123001A00_ATTCH1.docx、ATTCH2 文稿1_0123001A00_ATTCH2.pdf)

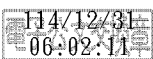
主旨：敬邀貴校師生參加「2026 日本大阪設計創意暨發明展」，並說明原「2026 日本東京設計創意暨發明展」活動異動事宜，請查照。

說明：

- 一、茲因 2026 年日本東京設計創意暨發明展主辦單位所使用之原訂場地，因配合定期更新及施工需求，原規劃於 2026 年 7 月 4 日至 7 月 5 日 假 東京 Bellesalle Haneda Airport Hall 舉辦之發明展覽活動，爰調整辦理地點與日期，改於 2026 年 7 月 3 日至 7 月 4 日 假 大阪 Kansai Airport Conference Halls 舉行，特此說明。如因此造成不便，尚祈 見諒。
- 二、2026日本大阪設計創意暨發明展將於115年7月3日~7月4日在大阪舉行，這是青年發明家和新銳設計師，促進國際交流與商業合作的最佳平台，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。
- 三、即日起報名至115年5月28日止，洽詢專線(02)8772-3898 分機19賴小姐或email至wiipa168@wiipa.org.tw。



正本：國立臺北科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設專科進修學校、崇右學校財團法人崇右影藝科技大學附設進修學院、國立臺灣科技大學、中國科技大學、德明財經科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、中華學校財團法人中華科技大學附設專科進修學校、城市學校財團法人臺北城市科技大學、黎明技術學院、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、耕莘健康管理專科學校、耕莘健康管理專科學校宜蘭分部、東南科技大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、景文科技大學、華夏學校財團法人華夏科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、明志科技大學、宏國學校財團法人宏國德霖科技大學、聖約翰科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、龍華科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、大華學校財團法人敏實科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、仁德醫護管理專科學校、修平學校財團法人修平科技大學、朝陽科技大學、弘光科技大學、嶺東科技大學、中臺科技大學、僑光科技大學、國立臺中科技大學、國立勤益科技大學、南開科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、大同技術學院、崇仁醫護管理專科學校、吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學、國立臺南護理專科學校、台南家專學校財團法人台南應用科技大學、中華醫事科技大學、敏惠醫護管理專科學校、南臺學校財團法人南臺科技大學、崑山科技大學、遠東科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、東方學校財團法人東方設計大學、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、國立高雄科技大學、樹德科技大學、國立高雄餐旅大學、輔英科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、國立臺東專科學校、國立屏東科技大學、慈惠醫護管理專科學校、大仁科技大學、美和學校財團法人美和科技大學、國立澎湖科技大學、聖母醫護管理專科學校、慈濟學校財團法人慈濟科技大學、大漢學校財團法人大漢技術學院

副本： 

施養晨 會長



2026 日本大阪設計創意暨發明展 報名表

連絡單位	中文名稱： 聯 絡 人： 職 稱： 連絡電話： 電子信箱：
參賽作品	中文名稱： 英文名稱：
參 賽 人 (至多 10 位)	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(未填者視同放棄縣市政府接見的機會)
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：





2026 日本大阪設計創意暨發明展 報名表

專利申請	☐ 已核准號碼_____ ☐ 申請中案號_____ ☐ 尚未申請
作品屬性	☐ 商品化 ☐ 原型 ☐ 模型 ☐ 圖稿
作品簡介	中文摘要：(不限字數) 英文摘要：(不限字數)
作品相片	



2026 日本大阪設計創意暨發明展

報名表



作品類別 (限勾選一項)	☐ 農業 ☐ 自動化與製造業 ☐ 汽車, 航天, 航空, 運輸 ☐ 美容, 醫藥與運動 ☐ 生物技術 ☐ 建築與結構 ☐ 兒童照護與特殊照護 ☐ 教育 ☐ 環境與能源 ☐ 設備, 電子產品與機械 ☐ 家用品與辦公用品 ☐ 通訊技術與視聽設備	☐ 工業設計 ☐ 時尚設計 ☐ 商業設計 ☐ 多媒體設計 ☐ 室內設計 ☐ 印刷包裝設計 ☐ 建築設計 ☐ 景觀設計 ☐ 模型設計 ☐ 視覺傳達設計 ☐ 工藝設計
參展目的	☐ 廣告曝光 ☐ 現場販售 ☐ 技術移轉 ☐ 代理合作 ☐ 批發合作 ☐ 製造合作 ☐ 個人履歷	
注意事項	1. Word 檔報名表請勿轉為 PDF 檔 2. 海報尺寸：56cm x 80cm (提交 PDF 檔案由大會統一免費製作) 3. 檔案傳送：wiipa168@wiipa.org.tw 4. 連絡電話：02-8772-3898 5. 報名日期：2026 年 5 月 28 日止 6. 繳費日期：2026 年 6 月 12 日截止，逾期取消參賽資格	
匯款資訊	台灣發明商品促進協會 元大銀行營業部 00108253826215	



2026日本大阪設計創意暨發明展：引領未來設計與發明新潮流

我們誠摯邀請您參加 2026 第 13 屆日本大阪設計創意暨發明展(JDIE)，由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）主辦。本屆展覽將與 2026 世界發明簡報技巧競賽同步舉行，於 2026 年 7 月 3 日至 7 月 4 日在大阪的 KANSAI AIRPORT CONFERENCE HALLS 展覽館盛大舉行。為期兩天的精彩展程將涵蓋展覽、交流和頒獎儀式，邀請您一同見證全球創新與設計的巔峰展示。



展會亮點



全方位展覽體驗

本屆展覽突破了傳統展覽的框架，為參展者創造了一個「無界限」的展示平台。無論您的作品是設計、發明、科技、藝術還是創意表演，都可以在這裡得到充分的展示，讓您的創意充分釋放。

全球創新與交流

展會吸引了來自世界各地的設計師和發明家，是一個極佳的國際交流平台。您將有機會與來自不同國家的創新者交流觀點，擴展您的專業網絡，並參與多場專題交流會和論壇，討論最新的行業趨勢和技術。

國際級專業評審

本次展會將由各國發明領袖和專家組成的評審團，對所有參展作品進行評審。最具創意和實用性的項目將在頒獎儀式上獲得榮譽獎項，提升您的專業聲譽。這不僅是對參展者創新能力的肯定，更是推動行業發展或升學的重要契機。

展覽資訊：

- 展覽日期：2026 年 7 月 3 日~7 月 4日
- 展覽地點：KANSAI AIRPORT CONFERENCE HALLS 展覽館
- 參展費用：48,000 元/件，包含 10 位發明人報名費、展位費、桌椅、電力海報印刷及評比費。
- 託展費用：10,000 元/件：包含現場布置、解說及作品運送。

重要時程

日期	時間	活動
7 月 3 日(五)	09：30~10：00	展位布置
	11：00~17：00	作品評比
7 月 4 日(六)	10：00~14：00	國際交流
	14：00~16：00	頒獎典禮
	16：00	大合照

報名資訊：

- 報名單位：台灣發明商品促進協會（TIPPA）
- 報名截止：2026 年 5 月 28 日
- 繳費截止：2026 年 6 月 12 日（逾期將取消參賽資格）
- 聯絡電話：02-8772-3898 賴秘書
- 電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw
- 協會網址：www.tippa.org.tw



匯款帳號：

- 戶名：台灣發明商品促進協會
- 銀行：元大銀行 營業部
- 帳號：00108253826215

我們誠摯地期待您的參與，讓台灣的發明創意在全球舞台上展現光彩。這不僅是一個展示您的創新成果的機會，也是一次拓展國際視野的寶貴經歷。參加本次展會，您將有機會與全球領先的創新者建立聯繫，探索最新的技術趨勢，並在國際平台上提升您的專業形象。期待在 2026 年 7 月 3 日至 7 月 4 日與您相會，共同見證未來設計與發明的新潮流。